



化工新材料

优于大市（维持）

证券分析师

李骥

资格编号：S0120521020005

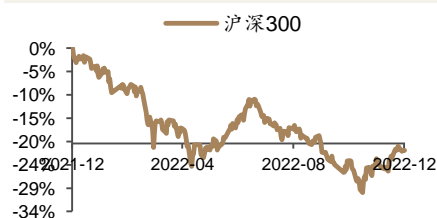
邮箱：lij3@tebon.com.cn

研究助理

沈颖洁

邮箱：shenyj@tebon.com.cn

市场表现



相关研究

- 《化工行业周报（20221202-20221209）-英力士入股中国石化天津南港乙烯项目，永和股份将收购石磊氟化工100%股权》，2022.12.12
- 《2023年全球半导体收入增长将下降，上海新阳KrF光刻胶已批量生产销售》，2022.12.12
- 《化工行业周报（20221125-202211202）-东方盛虹投资多个新材料项目，万华化学宣布年度最大幅降价》，2022.12.4
- 《2023年全球半导体市场预期将缩小4.1%，浙江大和半导体产业园三期项目封顶计划明年5月竣工》，2022.12.4
- 《光威复材（300699.SZ）：全产业链布局，军民共筑碳纤维龙头》，2022.11.29

2021至2023全球新建的84座晶圆厂中大陆新厂预计数量第一，广信材料拟设子公司加速光刻胶布局

投资要点：

- 本周行情回顾。**本周，Wind新材料指数收报4384.44点，环比下跌2.71%。其中，涨幅前五的有道恩股份(18.08%)、飞凯材料(7.07%)、润阳科技(6.89%)、仙鹤股份(4.77%)、国瓷材料(4.15%)；跌幅前五的有赛伍技术(-17.73%)、双星新材(-10.82%)、东材科技(-10.18%)、合盛硅业(-9.59%)、金博股份(-9.39%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7049.89点，环比下跌1.1%；申万三级行业显示器件材料指数收报939.01点，环比下跌0.95%；中信三级行业有机硅材料指数收报8705.48点，环比下跌3.69%；中信三级行业碳纤维指数收报4195.54点，环比下跌8.6%；中信三级行业锂电指数收报3897.69点，环比下跌4.86%；Wind概念可降解塑料指数收报1948.27点，环比下跌0.32%。
- 2021至2023全球新建84座晶圆厂，大陆新厂预计数量第一。**SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》中表明，从2021到明年，预计美洲将开始建设18座新工厂/产线。而欧洲/中东地区也在《欧洲芯片法案》的推动下，对新半导体工厂的投资预计将达到该地区的历史最高水平。该地区在2021至2023年间，将有17座Fab厂开工建设。预计中国台湾地区将开始建设14个新工厂/产线，而日本和东南亚预计将在预测期内分别开始建设6个，韩国预计将开始建设3个。据SEMI此前报告，由于功率半导体和MEMS的产能扩张，从2021年到2025年，全球半导体制造商将8英寸晶圆厂产能增加20%，超过700万片/月。其中，中国大陆将在200毫米产能扩张方面领先世界，到2025年将增长66%。到2022年，中国大陆预计将占据全球200毫米晶圆厂产能的21%。12英寸晶圆厂展望方面，SEMI表示，2022年至2025年，预计全球半导体制造商将以近10%的复合平均增长率(CAGR)扩大产能，届时预计达到920万片/月的历史新高。其中，中国大陆12英寸晶圆厂产能中的全球份额预计从2021年的19%提高到2025年的23%，达到230万/月。这一增长受到政府对国内芯片行业投资增加等因素的推动。随着增长，中国大陆在12英寸晶圆厂产能方面正接近全球领先的韩国，并有望在明年超越中国台湾，目前位居第二。（资料来源：半导体前沿、SEMI中国等）
- 广信材料拟设子公司，加速光刻胶布局。**12月14日，广信材料发布公告称，公司为满足公司战略发展需要，加速公司微电子材料产业布局，拓展产品市场潜力，提升上市公司核心竞争力，于2022年12月14日与尤家栋及锦龙科技在江苏省江阴市签订《投资协议》。本次投资完成后，扬明微电子将成为广信材料控股子公司，其将被纳入公司合并报表范围内。广信材料表示，本次对外投资设立江西扬明微电子材料有限公司，主要目的为进行光刻胶及配套电子材料的研发、制造、销售及技术服务。尤家栋是国内资深的电子化学品专家、高级工程师，曾担任苏州市电子材料厂有限公司厂长、总经理、董事长，苏州瑞红电子化学品有限公司总经理、董事长，苏州晶瑞化学股份有限公司董事、董事长，其参与了光刻胶重大科技攻关项目（包括863计划），领导和主持承担了国家02重大专项（i线，248光刻胶产业化），为国内资深光刻胶产业领军人物。尤家栋先生目前为公司微电子材料事业部项目总监，全面主持公司微电子材料板块战略规划、项目设计、团队建设等工作。尤家栋先生及公司微电子材料事业部团队拥有光刻胶领域丰富的研发、生产和市场经验，为公司未来微电子材料发展提供核心技术支撑。（资料来源：半导体前沿、集微网）
- 重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。**光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材

在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注**华特气体**。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：**安集科技、鼎龙股份**。**下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期**。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司**国瓷材料**。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头**利安隆**。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业**合盛硅业**、EVA 粒子技术行业领先的**联泓新科**、拥有三氯氢硅产能的**新安股份**以及**三孚股份**。

- **风险提示：**下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。

行业相关股票

股票代码	股票名称	EPS(元/股)			PE			投资上期	评级本期
		2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E		
300285	国瓷材料	0.79	1.08	1.45	38	28	21	买入	买入
002810	山东赫达	0.96	1.60	2.19	64	15	11	买入	买入
002409	雅克科技	0.70	1.33	1.83	115	39	28	买入	买入
688550	瑞联新材	2.44	4.58	5.84	41	11	8	买入	买入
688300	联瑞新材	1.39	2.70	3.62	80	20	15	买入	买入
688268	华特气体	1.08	1.48	2.13	84	50	35	买入	买入
300019	硅宝科技	0.68	0.96	1.27	23	17	13	买入	买入

资料来源：德邦研究所

注：上述公司估值均采用 12 月 16 日收盘价。

内容目录

1. 整体市场行情回顾	5
2. 重点关注公司周行情回顾	6
2.1. 周涨跌幅前十	6
2.2. 重要公告	7
2.3. 重点公司估值一览	7
3. 近期行业热点跟踪	9
3.1. 中共中央、国务院：在集成电路等领域实施一批国家重大科技项目	9
3.2. 2021 至 2023 全球新建 84 座晶圆厂，大陆新厂预计数量第一	9
3.3. 广信材料拟设子公司，加速光刻胶布局	10
3.4. 东丽商业化不含 NMP 的感光性聚酰亚胺涂料	11
3.5. 韩国 TEMC 公司向三星电子供应半导体用特气	11
4. 相关数据追踪	12
5. 风险提示	13

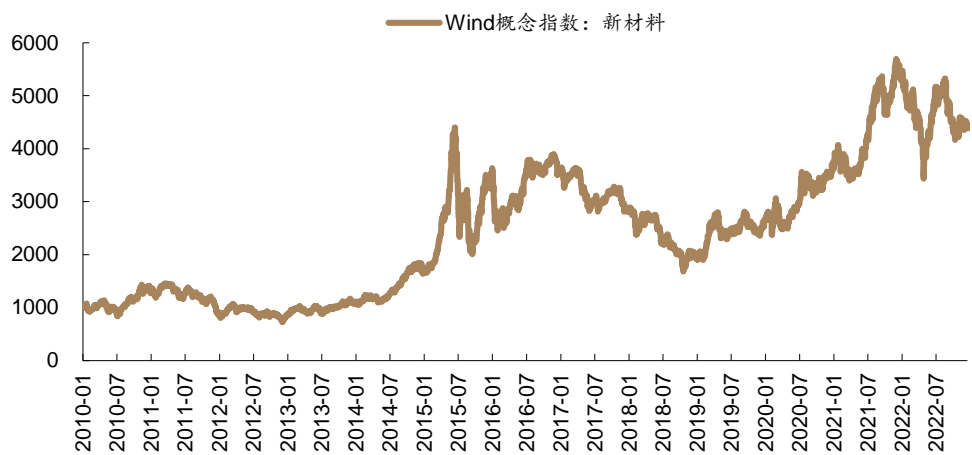
图表目录

图 1: Wind 概念新材料指数	5
图 2: 申万行业半导体材料指数	5
图 3: 申万行业显示器件指数	5
图 4: 中信行业有机硅指数	5
图 5: 中信行业碳纤维指数	5
图 6: 中信行业锂电化学品指数	6
图 7: Wind 概念可降解塑料指数	6
图 8: 费城半导体指数	12
图 9: 国产集成电路当月出口金额 (万美元)	12
图 10: 国产集成电路当月进口金额 (万美元)	12
图 11: NAND Flash 日度价格图 (美元)	13
图 12: DRAM DDR3 日度价格图 (美元)	13
表 1: 本周涨跌幅前十	6
表 2: 本周涨跌幅后十	6
表 3: 重点公司估值表	7

1. 整体市场行情回顾

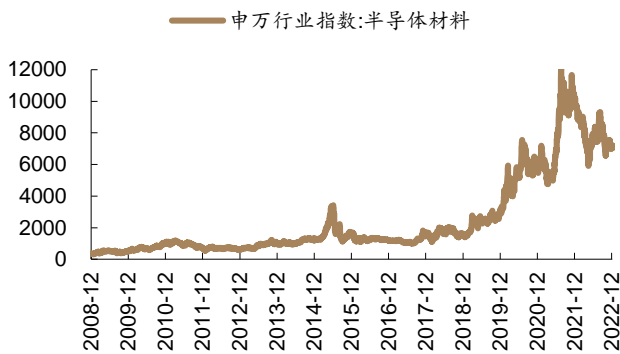
本周，Wind 新材料指数收报 4384.44 点，环比下跌 2.71%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报 7049.89 点，环比下跌 1.1%；申万三级行业显示器件材料指数收报 939.01 点，环比下跌 0.95%；中信三级行业有机硅材料指数收报 8705.48 点，环比下跌 3.69%；中信三级行业碳纤维指数收报 4195.54 点，环比下跌 8.6%；中信三级行业锂电指数收报 3897.69 点，环比下跌 4.86%；Wind 概念可降解塑料指数收报 1948.27 点，环比下跌 0.32%。

图 1: Wind 概念新材料指数



资料来源: Wind, 德邦研究所

图 2: 申万行业半导体材料指数



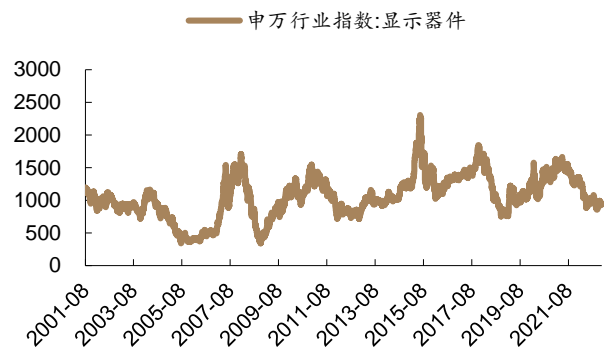
资料来源: Wind, 德邦研究所

图 4: 中信行业有机硅指数



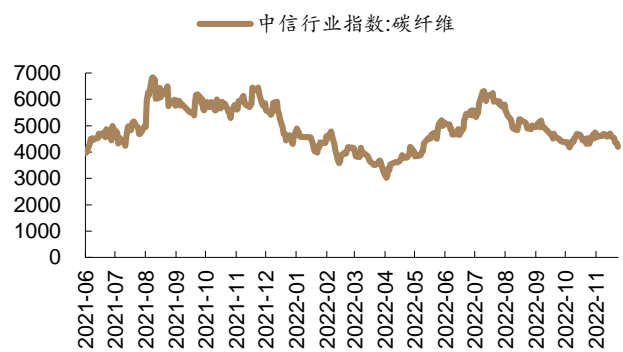
资料来源: Wind, 德邦研究所

图 3: 申万行业显示器件指数



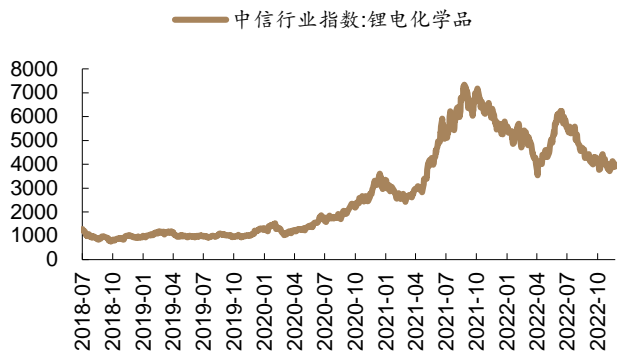
资料来源: Wind, 德邦研究所

图 5: 中信行业碳纤维指数



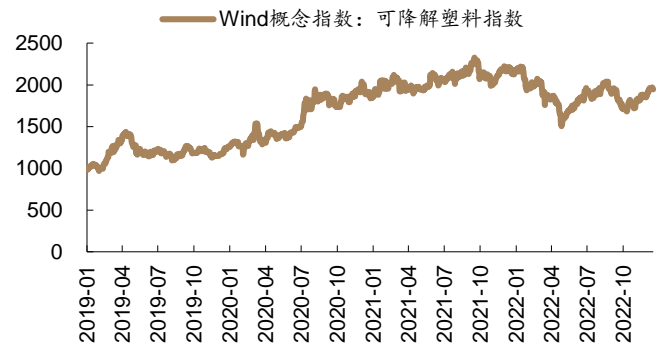
资料来源: Wind, 德邦研究所

图 6：中信行业锂电化学品指数



资料来源：Wind，德邦研究所

图 7：Wind 概念可降解塑料指数



资料来源：Wind，德邦研究所

2. 重点关注公司周行情回顾

2.1. 周涨跌幅前十

本周，涨幅前十的公司分别为：道恩股份(18.08%)、飞凯材料(7.07%)、润阳科技(6.89%)、仙鹤股份(4.77%)、国瓷材料(4.15%)、南大光电(2.83%)、长阳科技(2.6%)、晶瑞电材(1.44%)、浙江众成(1.12%)、皇马科技(1.02%)。

表 1：本周涨跌幅前十

	代码	名称	涨跌幅	市值(亿元)
1	002838	道恩股份	18.08%	108.61
2	300398	飞凯材料	7.07%	97.64
3	300920	润阳科技	6.89%	18.93
4	603733	仙鹤股份	4.77%	223.37
5	300285	国瓷材料	4.15%	304.56
6	300346	南大光电	2.83%	173.61
7	688299	长阳科技	2.60%	54.24
8	300655	晶瑞电材	1.44%	94.86
9	002522	浙江众成	1.12%	49.00
10	603181	皇马科技	1.02%	81.95

资料来源：Wind，德邦研究所

备注：以上数据采取 12 月 16 日收盘价。

本周，跌幅前十的公司分别为：赛伍技术(-17.73%)、双星新材(-10.82%)、东材科技(-10.18%)、合盛硅业(-9.59%)、金博股份(-9.39%)、斯迪克(-8.74%)、蓝晓科技(-7.95%)、华特气体(-7.44%)、濮阳惠成(-6.87%)、确成股份(-6.81%)。

表 2：本周涨跌幅后十

	代码	名称	涨跌幅	市值(亿元)
1	603212	赛伍技术	-17.73%	129.38
2	002585	双星新材	-10.82%	155.29
3	601208	东材科技	-10.18%	103.52
4	603260	合盛硅业	-9.59%	980.82
5	688598	金博股份	-9.39%	225.40
6	300806	斯迪克	-8.74%	72.39
7	300487	蓝晓科技	-7.95%	241.77
8	688268	华特气体	-7.44%	89.05

9	300481	濮阳惠成	-6.87%	78.39
10	605183	确成股份	-6.81%	76.60

资料来源：Wind，德邦研究所

备注：以上数据采取 12 月 16 日收盘价。

2.2. 重要公告

【长鸿高科 (605008.SH)】 12 月 14 日，宁波长鸿高分子科技股份有限公司公告称，其全资子公司长鸿生物拟与贺州市人民政府签订《投资协议书》，并将采取设立子公司广西长鸿生物材料有限公司（暂定名）的方式投建“长鸿生物降解母粒产业园项目”，即 100 万吨/年高端改性碳酸钙、120 万吨/年功能母粒一体化项目、10 万吨/年可降解制品及农用地膜，相应配套设施。该项目预计投资总金额 30 亿元。

【圣泉集团 (605589.SH)】 12 月 16 日，圣泉集团发布公告，根据公司发展及战略规划的要求，公司拟采用自主研发的生物质精炼技术，投资 24.80 亿元建设年产 10 万吨生物基硬碳负极材料项目，打造生物质精炼一体化产业集群，促进区域经济高质量发展。该项目建成投产后，可年产硬碳负极材料 10 万吨/年，纤维素浆 15 万吨/年，纳米纤维素浆 1 万吨/年，纳米纤维素 4 万吨/年，糠醛 1.2 万吨/年，乙酸 1.05 万吨/年，钾盐 0.5 万吨/年。

【广信材料 (300537.SZ)】 12 月 14 日，广信材料发布公告，拟以自有或自筹资金出资 600 万元与尤家栋及广州锦龙科技发展有限公司在江西省龙南市共同投资设立“江西扬明微电子材料有限公司”（暂定名称），进行光刻胶及配套电子材料研发、制造、销售及技术服务。

【康达新材 (002669.SZ)】 12 月 17 日，康达新材料（集团）股份有限公司符合相关规定，于近日收到上海市高新技术成果转化项目财政专项资金 782.2 万元，该笔专项资金占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 35.56%。本次政府补助为企业高新技术成果转化项目财政专项资金，具有偶发性，是否持续存在不确定性。

【瑞丰高材 (300243.SZ)】 12 月 14 日，瑞丰高材发布 2022 年度向特定对象发行股票预案。公司为提高控股股东持股比例，提振市场信心以及围绕公司发展战略为公司提供更多资金支持，决定向特定对象发行股票。本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式，在通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发行。本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人周仕斌先生。本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。本次发行股票的数量不超过 14,957,264 股（含本数），拟募集的资金总额不超过 10,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。

2.3. 重点公司估值一览

表 3：重点公司估值表

代码	证券简称	最新收盘价 (元)	市值 (亿元)	EPS (元/股)				PE			
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
002129	中环股份	37.98	1227.41	1.25	2.26	2.88	3.46	33	17	13	11
300346	南大光电	31.93	173.61	0.25	0.48	0.67	0.89	185	67	47	36

002409	雅克科技	51.20	243.67	0.70	1.33	1.83	2.46	115	39	28	21
688106	金宏气体	19.91	96.69	0.34	0.52	0.77	1.04	81	38	26	19
688268	华特气体	74.04	89.05	1.08	1.48	2.13	2.90	84	50	35	26
300236	上海新阳	30.00	94.01	0.33	0.40	0.84	1.30	123	75	36	23
603078	江化微	22.71	67.37	0.19	0.47	0.71	0.99	140	48	32	23
688019	安集科技	180.88	135.12	1.67	3.40	5.39	7.42	163	53	34	24
300054	鼎龙股份	22.18	210.19	0.23	0.42	0.61	0.81	108	53	36	27
688199	久日新材	33.72	37.51	1.49	1.39	1.92	2.55	28	24	18	13
300398	飞凯材料	18.47	97.64	0.73	0.79	0.88	0.97	33	23	21	19
300655	晶瑞股份	16.21	94.86	0.34	0.29	0.41	0.57	122	56	39	29
603650	彤程新材	33.84	201.73	0.55	0.56	0.87	1.20	92	61	39	28
300487	蓝晓科技	72.15	241.77	0.93	1.58	2.27	2.86	106	46	32	25
300481	濮阳惠成	26.45	78.39	0.85	1.41	1.83	2.27	28	19	14	12
603212	赛伍技术	29.38	129.38	0.39	0.76	1.12	1.43	81	39	26	21
688181	八亿时空	39.10	37.72	2.14	2.40	2.78	3.21	22	16	14	12
688550	瑞联新材	48.97	48.03	2.44	4.58	5.84	4.76	41	11	8	10
688300	联瑞新材	53.80	67.07	1.39	2.70	3.62	4.61	80	20	15	12
688378	奥来德	52.25	53.64	1.33	1.75	2.61	3.77	60	30	20	14
603260	合盛硅业	91.31	980.82	7.64	5.84	8.58	9.85	17	16	11	9
300041	回天新材	16.78	72.30	0.53	0.75	1.00	1.33	35	23	17	13
300019	硅宝科技	15.97	62.46	0.68	0.96	1.27	1.69	23	17	13	9
300821	东岳硅材	12.83	153.96	0.96	-	-	-	19	-	-	-
603155	新亚强	28.52	64.33	1.42	1.70	2.40	2.87	38	17	12	10
605399	晨光新材	33.90	81.45	2.23	3.03	3.76	5.08	18	11	9	7
605183	确成股份	18.35	76.60	0.72	0.97	1.18	1.46	27	19	15	13
002810	山东赫达	24.03	82.29	0.96	1.60	2.19	2.31	64	15	11	10
603806	福斯特	60.50	805.58	1.65	1.92	2.62	3.12	79	32	23	19
003022	联泓新科	29.51	394.13	0.82	0.98	1.28	1.56	45	30	23	19
300285	国瓷材料	30.34	304.56	0.79	1.08	1.45	1.88	38	28	21	16
300699	光威复材	71.37	369.95	1.46	1.90	2.40	2.93	58	38	30	24
600516	方大炭素	6.38	242.82	0.28	0.23	0.35	0.49	38	28	18	13
600884	杉杉股份	18.42	414.53	1.48	1.41	1.78	2.21	22	13	10	8
300596	利安隆	53.89	123.74	1.82	2.70	3.38	3.82	25	20	16	14
603733	仙鹤股份	31.64	223.37	1.44	1.14	1.69	2.13	28	28	19	15
300829	金丹科技	24.94	45.06	0.73	0.99	1.39	2.20	62	25	18	11
600143	金发科技	10.72	284.85	0.63	0.68	0.87	1.07	20	16	12	10
002585	双星新材	13.43	155.29	1.20	1.53	2.13	2.83	23	9	6	5
688299	长阳科技	18.91	54.24	0.65	0.71	0.97	1.25	50	27	19	15
300806	斯迪克	23.82	72.39	0.69	0.84	1.29	1.92	85	28	18	12
601208	东材科技	11.29	103.52	0.37	0.48	0.65	0.91	47	23	17	12
688386	泛亚微透	58.83	41.18	0.95	0.99	1.84	2.55	85	59	32	23
300777	中简科技	49.30	216.71	0.46	1.03	1.56	1.95	135	48	32	25
688598	金博股份	239.60	225.40	5.33	6.97	9.09	12.22	67	34	26	20
002522	浙江众成	5.41	49.00	0.20	-	-	-	36	-	-	-
600063	皖维高新	6.16	133.01	0.45	0.79	0.91	1.05	13	8	7	6
002324	普利特	16.24	164.68	0.02	0.28	0.74	1.09	603	57	22	15
300082	奥克股份	8.54	58.08	0.52	-	-	-	30	-	-	-
603181	皇马科技	13.92	81.95	0.76	0.84	0.99	1.24	25	16	14	11
002838	道恩股份	24.30	108.61	0.51	-	-	-	32	-	-	-
688357	建龙微纳	96.54	57.39	4.63	3.62	5.63	7.56	41	27	17	13
600552	凯盛科技	9.97	94.18	0.17	0.17	0.29	0.44	70	58	34	23
300121	阳谷华泰	11.10	44.93	0.70	1.48	1.76	2.13	17	8	6	5
002768	国恩股份	28.86	78.28	2.37	2.77	3.82	4.50	11	10	8	6
605376	博迁新材	46.02	120.39	0.91	0.96	1.37	1.70	92	48	33	27
688065	凯赛生物	63.24	368.87	1.04	1.21	1.63	2.15	177	52	39	29
603722	阿科力	43.01	37.82	1.14	1.59	1.94	3.51	47	27	22	12
688179	阿拉丁	39.22	55.42	0.63	0.82	1.10	1.48	124	48	35	27

603663	三祥新材	13.08	39.54	0.33	0.59	0.88	1.11	83	22	15	12
300243	瑞丰高材	8.79	20.42	0.40	-	-	-	33	-	-	-
002886	沃特股份	16.28	36.89	0.28	0.27	0.86	1.50	111	61	19	11
605008	长鸿高科	18.00	115.63	0.29	0.43	0.66	1.27	51	42	27	14
300920	润阳科技	18.93	18.93	0.90	2.01	2.72	-	38	9	7	-
300980	祥源新材	18.90	20.47	0.81	1	1	1	52	19	16	13

资料来源: Wind, 德邦研究所

注: 硅宝科技、利安隆、雅克科技、国瓷材料、山东赫达、瑞联新材、联瑞新材、华特气体估值均为德邦预测, 其余公司估值来自于 wind 一致预测, 收盘价更新于 12 月 16 日。

3. 近期行业热点跟踪

3.1. 中共中央、国务院：在集成电路等领域实施一批国家重大科技项目

近日, 中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》(以下简称《规划纲要》), 其中要求“加快发展产业新产品”, 提出“推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用”等内容。

《规划纲要》提出, 实现科技高水平自立自强。以国家战略性需求为导向推进创新体系优化组合, 强化以国家实验室为引领的战略科技力量。在人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域实施一批前瞻性、战略性国家重大科技项目。

聚焦核心基础零部件及元器件、关键基础材料、关键基础软件、先进基础工艺和产业技术基础, 引导产业链上下游联合攻关。持之以恒加强基础研究, 发挥好重要院所、高校的国家队作用, 重点布局一批基础学科研究中心。加强科学研究与市场应用的有效衔接, 支持产学研协同, 促进产业链、创新链、生态链融通发展。强化企业科技创新主体作用。同时壮大战略性新兴产业。全面提升信息技术产业核心竞争力, 推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。围绕新一代信息技术、新材料、高端装备、新能源汽车等关键领域, 5G、集成电路、人工智能等产业链核心环节, 推进国家战略性新兴产业集群发展工程, 实施先进制造业集群发展专项行动, 培育一批集群标杆, 探索在集群中试点建设一批创新和公共服务综合体。在前沿科技和产业变革领域, 组织实施未来产业孵化与加速计划, 前瞻谋划未来产业。推动先进制造业集群发展, 建设国家新型工业化产业示范基地, 培育世界级先进制造业集群。

此外, 《规划纲要》还要求, 加强创新产品应用。依托我国超大规模市场和完备产业体系, 创造有利于新技术快速大规模应用和迭代升级的独特优势, 加速科技成果向现实生产力转化。完善激励和风险补偿机制, 推动首台(套)装备、首批次材料等示范应用。建立重要产品快速审评审批机制。(资料来源: 全球半导体观察)

3.2. 2021 至 2023 全球新建 84 座晶圆厂, 大陆新厂预计数量第一

SEMI 在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》中表明, 预计全球半导体行业将在 2021 至 2023 年间建设 84 座大规模芯片制造工厂, 并投资 5000 多亿美元。增长预期包括今年开始建设的 33 家新工厂和预计 2023 年将新增的 28 家工厂。SEMI 指出, 在这些新增的晶圆厂中, 包括汽车和高性能计算在内的细分市场将推动其支出增长。SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示, 最新报告反映了半

导体对世界各国和众多行业的战略重要性日益增加，其中，政府激励措施在扩大产能和加强供应链方面起到重大影响。他指出，看好半导体行业的长期前景，半导体制造业投资的增加对于为新兴应用驱动的长期增长奠定基础至关重要。

具体看来，《世界晶圆厂预测报告》划分出七个地区，列出晶圆代工厂/产线的数据。其中，美国、中国大陆、欧洲各有突破。在投资方面，美洲因美国的“芯片法案”的出台，使其在新资本支出方面的排名中独占鳌头。由于政府投资催生了新的芯片制造工厂和供应商支持生态系统，从 2021 到明年，预计美洲将开始建设 18 座新工厂/产线。而欧洲/中东地区也在《欧洲芯片法案》的推动下，对新半导体工厂的投资预计将达到该地区的历史最高水平。该地区在 2021 至 2023 年间，将有 17 座 Fab 厂开工建设。预计中国台湾地区将开始建设 14 个新工厂/产线，而日本和东南亚预计将在预测期内分别开始建设 6 个，韩国预计将开始建设 3 个。

据 SEMI 此前报告，由于功率半导体和 MEMS 的产能扩张，从 2021 年到 2025 年，全球半导体制造商将 8 英寸晶圆厂产能增加 20%，超过 700 万片/月。其中，中国大陆将在 200 毫米产能扩张方面领先世界，到 2025 年将增长 66%。到 2022 年，中国预计将占据全球 200 毫米晶圆厂产能的 21%。12 英寸晶圆厂展望方面，SEMI 表示，2022 年至 2025 年，预计全球半导体制造商将以近 10% 的复合平均增长率 (CAGR) 扩大产能，届时达到 920 万片/月的历史新高。其中，中国大陆 12 英寸晶圆厂产能中的全球份额预计将从 2021 年的 19% 提高到 2025 年的 23%，达到 230 万/月。这一增长受到政府对国内芯片行业投资增加等因素的推动。随着增长，中国大陆在 12 英寸晶圆厂产能方面正接近全球领先的韩国，并有望在明年超越中国台湾，目前位居第二。

此外，根据 Yole 的数据，全球目前有 150 多家 12 英寸晶圆厂，其中 42 家在中国台湾，33 家在中国大陆，19 家在美国，只有 12 家在欧洲和中东；8 英寸晶圆厂全球约有 230 家，其中 51 家在美国，49 家在欧洲和中东。（资料来源：半导体前沿、SEMI 中国等）

3.3. 广信材料拟设子公司，加速光刻胶布局

12 月 14 日，广信材料发布公告称，公司为满足公司战略发展需要，加速公司微电子材料产业布局，拓展产品市场潜力，提升上市公司核心竞争力，于 2022 年 12 月 14 日与尤家栋及锦龙科技在江苏省江阴市签订《投资协议》。

广信材料与尤家栋先生及锦龙科技在江西省龙南市共同投资设立“江西扬明微电子材料有限公司”（简称“合资公司”或“扬明微电”），进行光刻胶及配套电子材料研发、制造、销售及技术服务。据广信材料公司公告，扬明微电注册资本为 1,000 万元，其中广信材料出资 600 万元，持股比例为 60%；尤家栋与锦龙科技分别以自有资金出资 180 万元、220 万元，持股比例分别为 18%、22%。本次投资完成后，扬明微电将成为广信材料控股子公司，其将被纳入公司合并报表范围内。

广信材料表示，本次对外投资设立江西扬明微电子材料有限公司，主要目的

为进行光刻胶及配套电子材料的研发、制造、销售及技术服务。尤家栋是国内资深的电子化学品专家、高级工程师，曾担任苏州市电子材料厂有限公司厂长、总经理、董事长，苏州瑞红电子化学品有限公司总经理、董事长，苏州晶瑞化学股份有限公司董事、董事长，其参与了光刻胶重大科技攻关项目（包括 863 计划），领导和主持承担了国家 02 重大专项（i 线，248 光刻胶产业化），为国内资深光刻胶产业领军人物。尤家栋先生目前为公司微电子材料事业部项目总监，全面主持公司微电子材料板块战略规划、项目设计、团队建设等工作。尤家栋先生及公司微电子材料事业部团队拥有光刻胶领域丰富的研发、生产和市场经验，为公司未来微电子材料发展提供核心技术支撑。（资料来源：半导体前沿、集微网）

3.4. 东丽商业化不含 NMP 的感光性聚酰亚胺涂料

2022 年 12 月 14 日，东丽（Toray Industries, Inc.）宣布已开发出新型的 PHOTONEECE® 感光性聚酰亚胺涂料。这种改性材料采用不含 N-甲基-2-吡咯烷酮（NMP）的技术来降低该有机化合物对环境的潜在影响。该公司已为该新产品建立了量产系统，并将开始全面销售，主要用于功率半导体应用。

主要的半导体元器件创新推动了电动汽车、5G 通信、人工智能、虚拟世界和其他先进技术平台的迅猛发展。这些元器件的保护绝缘膜主要是聚酰亚胺材料，可以保护它们免受制造过程和其他热量的影响。随着环保理念深入人心，近年来，欧美努力规范作为聚酰亚胺材料溶剂的 NMP 的使用。这些举措促使东丽利用其多年来积累的功能性聚酰亚胺设计技术，创造一种用 NMP 替代品合成聚酰亚胺的技术。因此它可以提供不含 NMP（低于检测限（=5ppm））的材料。

东丽新型 PHOTONEECE 出色的耐热性和绝缘性能使其特别适用于制造过程需要大量热量的功率半导体。这些器件的运行电压也比普通半导体高得多。功率半导体也有需要特别高电压的应用，例如大型电动汽车、火车和发电站。对于这些应用，聚酰亚胺薄膜必须特别厚。尽管存在这些挑战，东丽还是能够开发出一种不含 NMP 的光敏聚酰亚胺材料，即使薄膜厚度超过 15 微米，也能实现与传统同类产品相同的高保真图案处理，通过应用增强光透明度的技术，厚度是那些同类产品的两倍多。

该公司的新材料与绝缘保护膜接触的硅、铜和其他基材具有很高的粘附性，目前正在一家主要的功率半导体制造商进行样品评估。（资料来源：艾邦半导体网）

3.5. 韩国 TEMC 公司向三星电子供应半导体用特气

CINNO Research 产业资讯，TEMC 是一家专门从事用于半导体加工的稀有和特殊气体的公司，从今年第三季度开始向三星电子供应其产品。随着 SK 海力士第二代技术创新企业 TEMC 成功为三星电子供货，韩国有望加快半导体特种气体国产化步伐。

TEMC 自今年第三季度以来一直在向三星电子供应半导体工艺中使用的特殊

气体。2018年,SK海力士被选为第二家技术创新公司,并被评为一合作伙伴。特别是今年与POSCO合作,成功实现了氙气的韩国国产化,备受瞩目。氙气是晶圆曝光工艺中使用的准分子激光气体的基本材料。从4月开始,SK海力士开始使用TEMC的氙气,并用TEMC的气体替代了大约一半的氙气总消耗量。

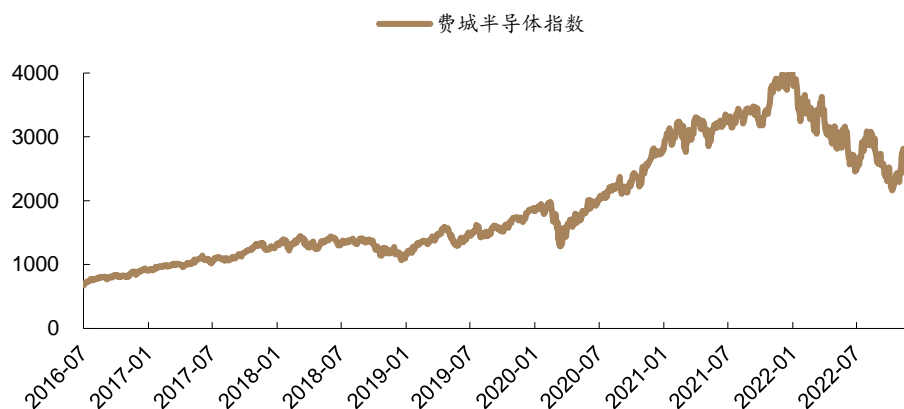
对此,出于安全考虑,三星电子并不倾向于选择同时向SK海力士和三星电子供货的供应商。不过,特种气体方面,正处于紧迫的开发阶段,而TEMC又是三星集团投资的公司,因此被解读为做出了这个选择。最近,由于日本的出口限制、美中争端和俄乌战争,半导体材料多样化的重要性越来越高。

同时,TEMC在通过上市预审后,于近日提交了证券报告书。计划公开发行的股票数量为220万股,希望公开发行的价格范围为32,000至38,000韩元。上市后的预期市值约为3537亿韩元至4201亿韩元。经过2023年1月4日、5日两天需求预测后,1月10日、11日进行普通投资者认购。上市管理人为韩华投资证券。(资料来源:CINNO)

4. 相关数据追踪

本周,费城半导体指数收报2636.1点,环比下跌3.12%。

图 8: 费城半导体指数

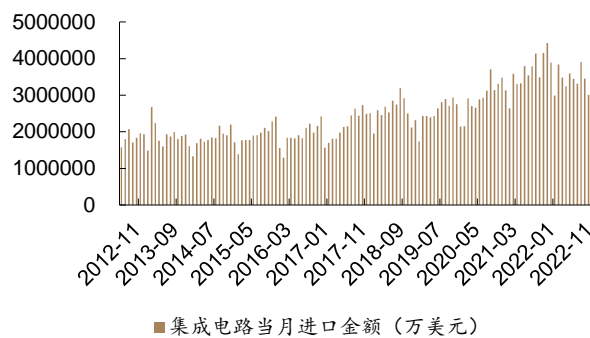
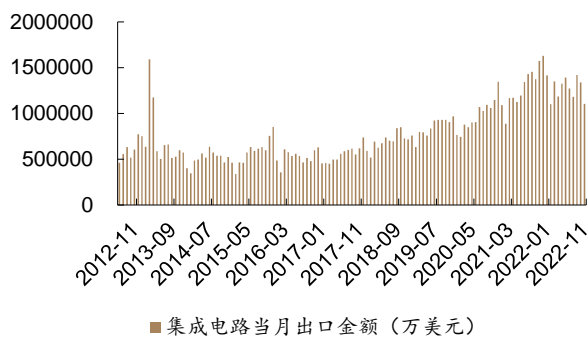


资料来源: Wind, 德邦研究所

11月,中国集成电路出口金额达到110.62亿美元,同比下跌29.8%,环比下跌17.49%;集成电路进口金额达到300.96亿美元,同比下跌27.58%,环比下跌12.81%。

图 9: 国产集成电路当月出口金额 (万美元)

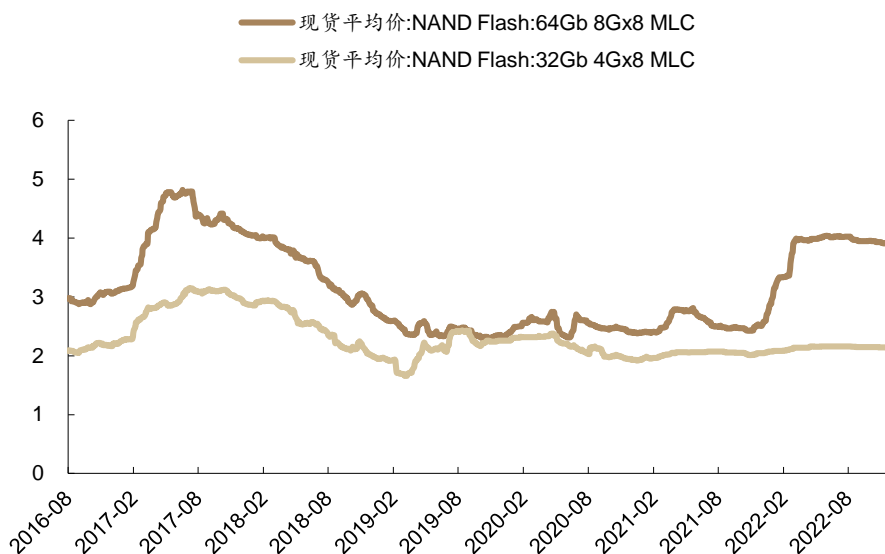
图 10: 国产集成电路当月进口金额 (万美元)



资料来源: Wind, 德邦研究所

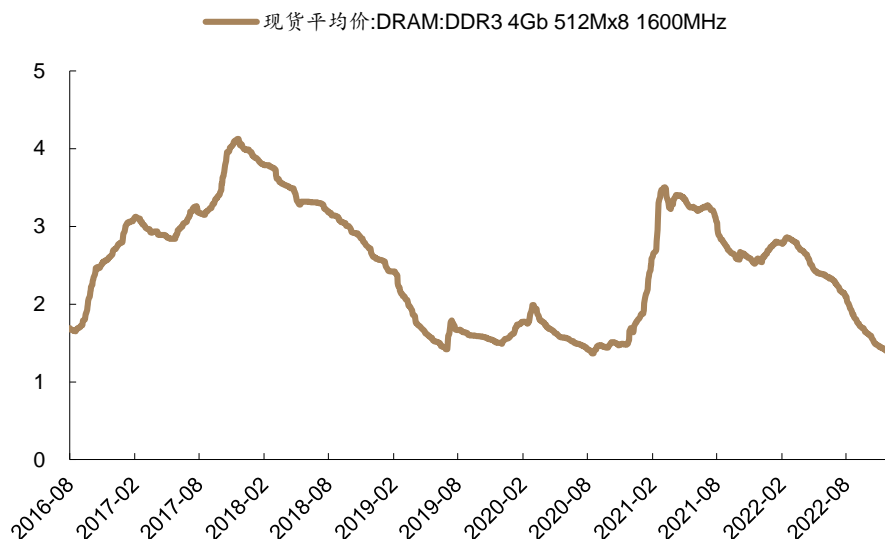
资料来源: Wind, 德邦研究所

图 11: NAND Flash 日度价格图 (美元)



资料来源: Wind, 德邦研究所

图 12: DRAM DDR3 日度价格图 (美元)



资料来源: Wind, 德邦研究所

5. 风险提示

下游需求不及预期, 产品价格波动风险, 新产能释放不及预期等。

信息披露

分析师与研究助理简介

李骥，德邦证券化工行业首席分析师&周期组执行组长，北京大学材料学博士，曾供职于海通证券有色金属团队，所在团队2017年获新财富最佳分析师评比有色金属类第3名、水晶球第4名。2018年加入民生证券，任化工行业首席分析师，研究扎实，推票能力强，佣金增速迅猛，2021年2月加盟德邦证券。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

类别	评级	说明
1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的6个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后6个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 2. 市场基准指数的比较标准： A股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	买入	相对强于市场表现 20%以上；
	增持	相对强于市场表现 5%~20%；
	中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持	相对弱于市场表现 5%以下。
行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
	中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
	弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。

法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。